

Un consortium de géants rallie IBM pour produire des 'wafers'

Surprenante réunion de géants de l'électronique pour investir 1,9 milliard de dollars dans une unité de fabrication de wafers – plaques de silicium sur lesquelles sont sérigraphiés les processeurs – SOI (

silicium on insulator) près de New York. IBM a réuni, au sein d'un consortium AMD, Chartered Semiconductor, Infineon, Samsung, Sony et Toshiba. D'autres acteurs en feraient partie, dont les équipementiers ASML Holding, Applied Materials et Tokyo Electron. Quels objectifs? De nombreuses questions se posent. La présence de géants de l'électronique d'origines diverses - japonais, sud-coréens, européens...- ainsi que divers équipementiers, surprend les analystes. Certains évoquent déjà un '*panier de crabes*' avec un compétiteur commun à tous: Intel. AMD avait annoncé il y a quelques mois le développement de composants en 60 et 45 nanomètres en partenariat avec IBM, mais le challenger d'Intel affirme que le projet n'a rien à voir avec le consortium. Sony travaille avec IBM au développement de 'Cell', un composant destiné au marché de l'électronique grand public, et qui devrait équiper la PlayStation 3 et réduire affronter avec force l'Xbox 2 de Microsoft. Mais les autres industriels sont-ils concernés ? En revanche, l'ampleur des investissements consentis, 1,9 milliard de dollar, pourrait se traduire par un rééquilibrage entre la côte ouest des Etats-Unis, avec la Silicon Valley, et la côte est, avec la Tech Valley. C'est d'ailleurs à East Fishkill, Etat de New York et c?ur de la Tech Valley, que l'équipementier hollandais ASML Holding va implanter son premier centre de recherche lithographie hors de l'Europe. Et avec la participation financière d'IBM ! Mais plus sûrement le consortium marque la recherche d'un contrepoids industriel, car l'ombre d'un grand absent plane au dessus du consortium, Intel?